附件1

2023年度车规级芯片科技攻关“揭榜挂帅”

榜单任务拟立项项目公示清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 榜单任务名称 | 牵头揭榜团队 |
| 1 | MCU类 新一代车双内核异构中央网关控制MCU芯片 | 北京芯驰半导体科技有限公司 |
| 2 | MCU类 一种通用性车规级MCU | 北京国科环宇科技股份有限公司 |
| 3 | 模拟类 一种具有自适应多级 MOSFET 栅极控制H桥驱动芯片 | 北京得谦微电子有限责任公司 |
| 4 | 模拟类 具有大驱动带诊断和嵌入式保护功能的高边开关芯片 | 北京宁海芯科集成电路设计有限公司 |
| 5 | 模拟类 带电流检测模拟反馈单通道高边驱动芯片 | 北京宁海芯科集成电路设计有限公司 |
| 6 | 模拟类 可配置的多通道高/低边驱动芯片 | 广东希荻微电子团队 |
| 7 | 模拟类 8通道完全可配置高/低侧 MOSFET预驱动芯片 | 北京得谦微电子有限责任公司 |
| 8 | 模拟类 全面保护的低边驱动器芯片 | 北京时代民芯科技有限公司 |
| 9 | 电源类 四路摄像头电源保护器 | 北京时代民芯科技有限公司 |
| 10 | 电源类 具有低静态电流双路同步降压控制器 | 北京智芯微电子科技有限公司 |